



## 检测报告

公司 : N/A  
地址 : N/A  
样品名称 : 集成电路  
型号 : HCS300-I/SN  
器件品牌 : Microchip  
批次代码 : 2137  
器件封装 : SOIC-8  
样品数量 : 9000 片  
检测数量 : 10 片  
收样日期 : 2023/03/20  
测试日期 : 2023/03/20/17:20 - 2023/03/21/18:20

### 声明:

附件中显示的测试是根据指示步骤进行的,我们对这些测试的准确性和完整性承担全部责任,并保证所有执行测试的人员的资格。



检测 Sine  
审核 Wu ZQ  
批准 Lucy

### 注意事项:

1. 报告无审核、批准人签章无效。
2. 报告未盖测试报告章及骑缝章无效。
3. 报告结论只对委托样品负责。
4. 报告未经本实验室书面批准不得部分复制。
5. 报告涂改无效。
6. 如对试验结果有异议,可按申诉程序要求执行。



# 创芯在线电子检测中心

网站: <https://www.iclabcn.com>  
地址: 深圳市福田区中航路鼎诚国际大厦2603  
电话: 0755-82719442 邮箱: [engineer@iclabcn.com](mailto:engineer@iclabcn.com)



报告编号:	SZ20230323018
日期:	2023/03/23
页码:	2/13

## 测试项目

- 外观检查
- 电特性测试
- 编程烧录
- 可焊性测试
- X-ray 检测
- ROHS 测试
- 关键功能测试
- 烘烤
- 编带
- 丙酮测试
- 开盖测试
- SAT 检测
- 切片测试

## 测试方法及测试设备

### 1.1 测试标准:

- AS6081

### 1.2 显微镜

- 设备规格:  
光学显微镜: SEZ-260 X7-X45 (设备有效期至: 2023-08-19)  
金相显微镜: FJ-4A X50-X1000 (设备有效期至: 2023-08-19)

### 1.3 功能测试设备

- 设备规格:  
半导体管特性图示仪: CA4810A (设备有效期至: 2023-08-19)





# 创芯在线电子检测中心

网站: <https://www.iclabcn.com>  
地址: 深圳市福田区中航路鼎诚国际大厦2603  
电话: 0755-82719442 邮箱: [engineer@iclabcn.com](mailto:engineer@iclabcn.com)



报告编号:	SZ20230323018
日期:	2023/03/23
页码:	3/13

## 1.4 检测依据

- 《Microchip HCS300-I/SN》:

<https://www.semice.com/file/EOL2/Microchip-HCS300.pdf>



## 测试结果

### 电特性测试:

电特性测试	结果:
测试总量:	10 片
通过数量:	10 片
失败数量:	0 片
注:	所有样品的引脚均符合厂商规格说明, 通过。

### 电特性测试结论:

故障分类	是/否	结论
结构异常	否	通过
开路	否	通过
短路	否	通过

### 开盖测试:

依据标准: AS6081

#### 结论描述:

随机抽取客户提供制造商为 Microchip 型号 HCS300-I/SN 的样品 2 片 (#1-#2) 进行开盖检查。

#### 测试结果:

2 片样品开盖后均发现 Microchip 厂商标记和 1995 版权年及晶圆代码 77410 且结构一致。

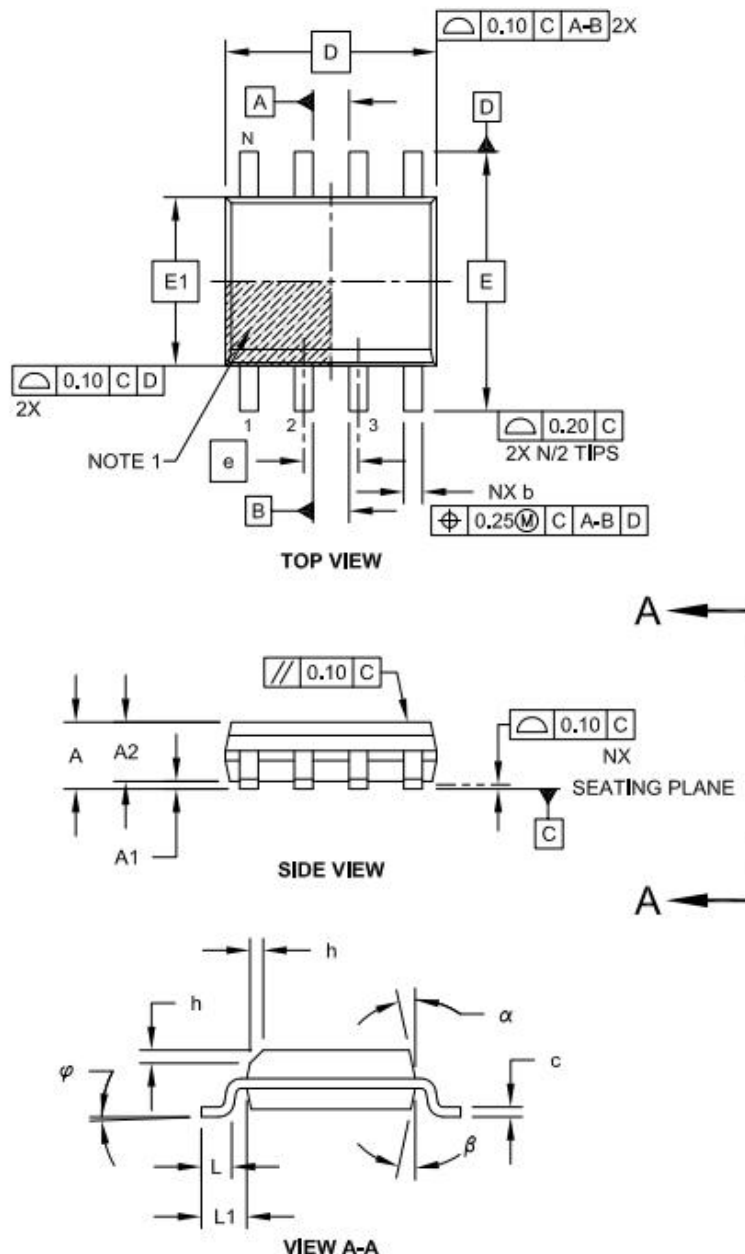
#### 测试结论:

确认2片样品die均为Microchip厂商产品。

## 1. 芯片描述:

HCS300是一款跳码编码器, 专为安全的遥控无钥匙进入(RKE)系统设计。HCS300采用KEELOQ®跳码技术, 具有高安全性、小封装外形和低成本。HCS300是单向遥控无钥匙进入系统和门禁系统的完美解决方案。

## 2. 封装尺寸:





# 创芯在线电子检测中心

网站: <https://www.iclabcn.com>  
地址: 深圳市福田区中航路鼎诚国际大厦2603  
电话: 0755-82719442 邮箱: [engineer@iclabcn.com](mailto:engineer@iclabcn.com)



报告编号:	SZ20230323018
日期:	2023/03/23
页码:	6/13

Dimension Limits	Units	MILLIMETERS		
		MIN	NOM	MAX
Number of Pins	N	8		
Pitch	e	1.27 BSC		
Overall Height	A	-	-	1.75
Molded Package Thickness	A2	1.25	-	-
Standoff §	A1	0.10	-	0.25
Overall Width	E	6.00 BSC		
Molded Package Width	E1	3.90 BSC		
Overall Length	D	4.90 BSC		
Chamfer (Optional)	h	0.25	-	0.50
Foot Length	L	0.40	-	1.27
Footprint	L1	1.04 REF		
Foot Angle	$\varphi$	0°	-	8°
Lead Thickness	c	0.17	-	0.25
Lead Width	b	0.31	-	0.51
Mold Draft Angle Top	$\alpha$	5°	-	15°
Mold Draft Angle Bottom	$\beta$	5°	-	15°



## 3.来料信息:

重量:	1800 g	样品数量	9000片
箱子数量	N/A	完整标签	存在
封装类型	管装	防潮保护	不存在
MSL等级	1	ESD保护	存在

备注: 共收到客户提供的 9000 片样品, 抽测样品 10 片。

来料图片-1



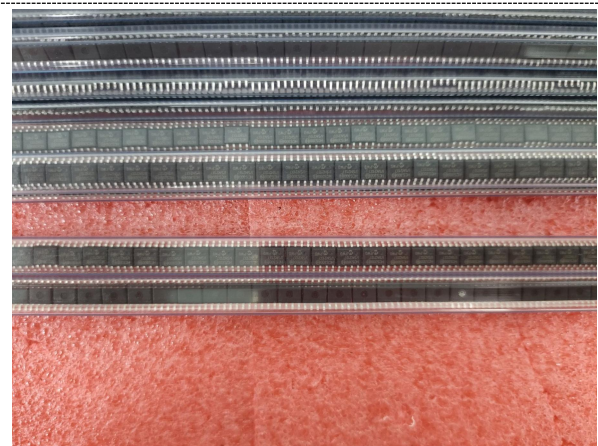
来料图片-2



来料图片-3



来料图片-4



## 4.电特性测试:

依据标准: AS6081

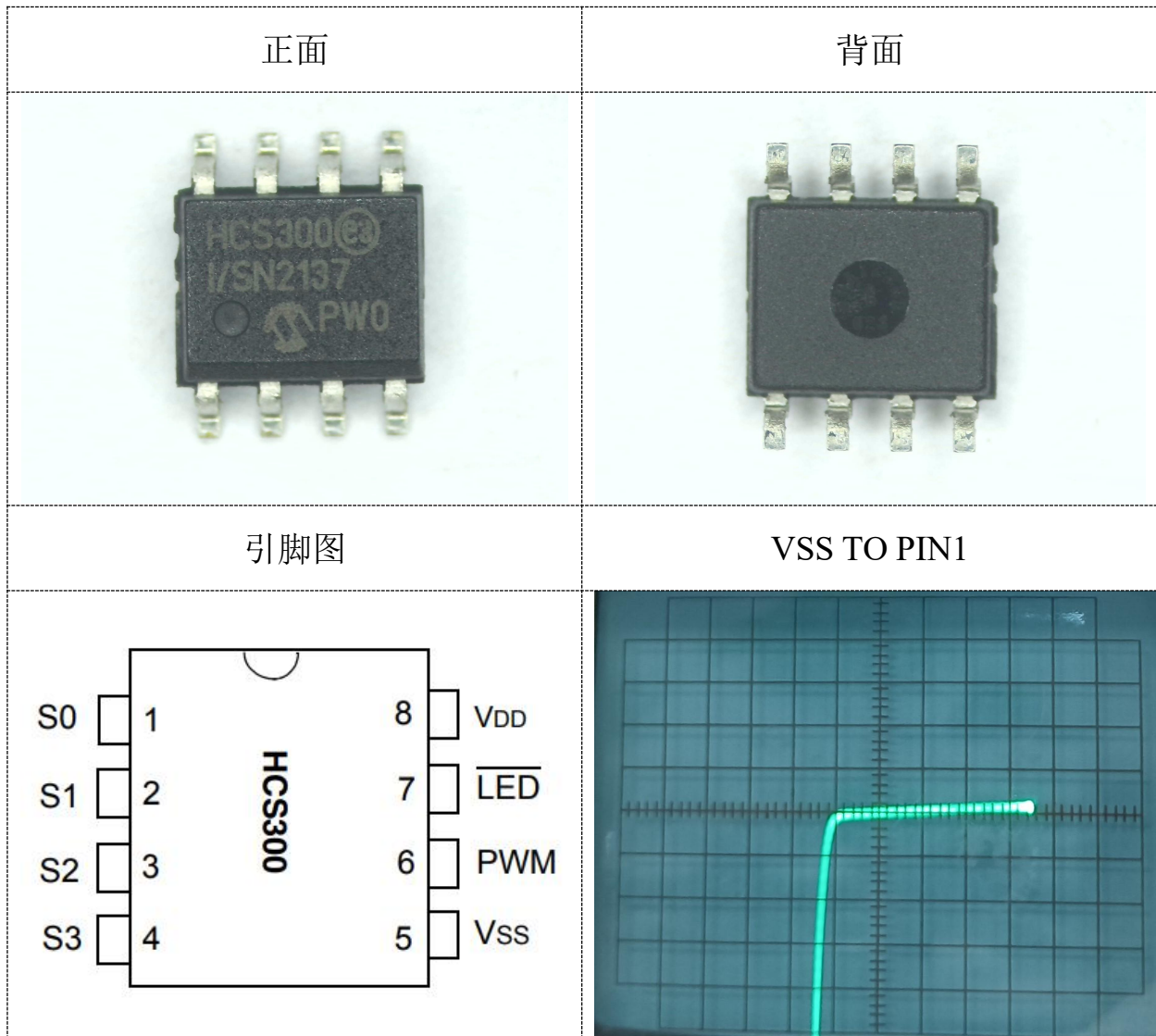
检测环境 环境温度: 25.8 °C; 相对湿度: 57.3% RH

使用半导体管特性图示仪验证芯片管脚电特性曲线, 通过开路/短路测试检查芯片是否损坏。

测试条件:

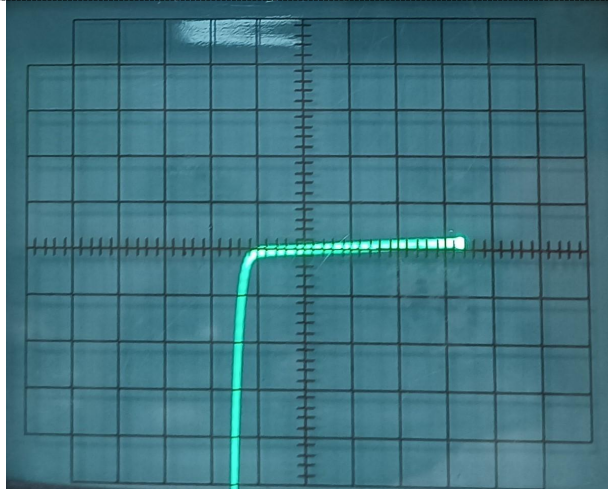
横轴:  $X = 0.5V/div$ ;

纵轴:  $Y = 0.5mA/div$ 。

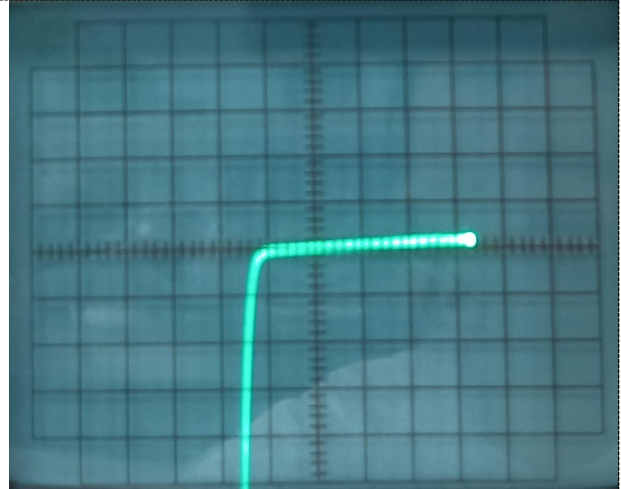




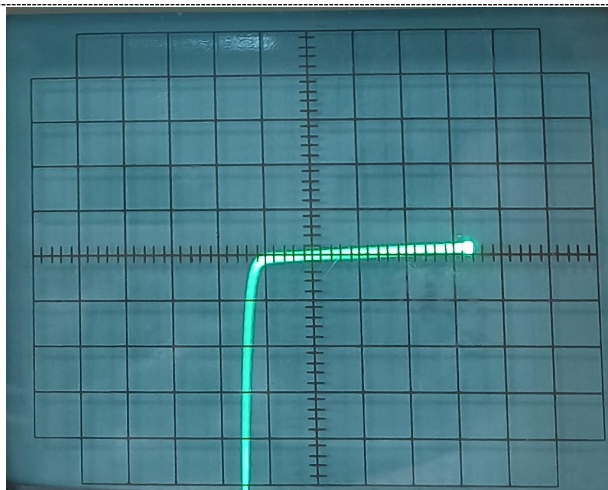
VSS TO PIN2



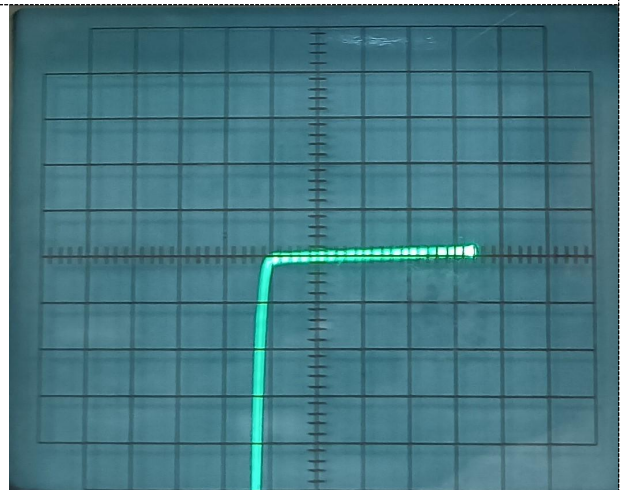
VSS TO PIN3



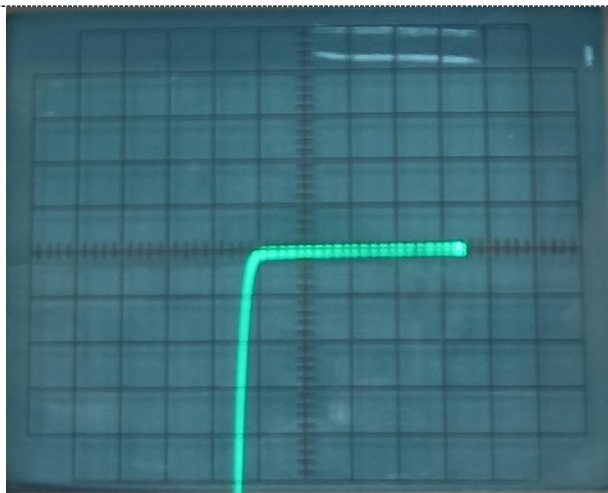
VSS TO PIN4



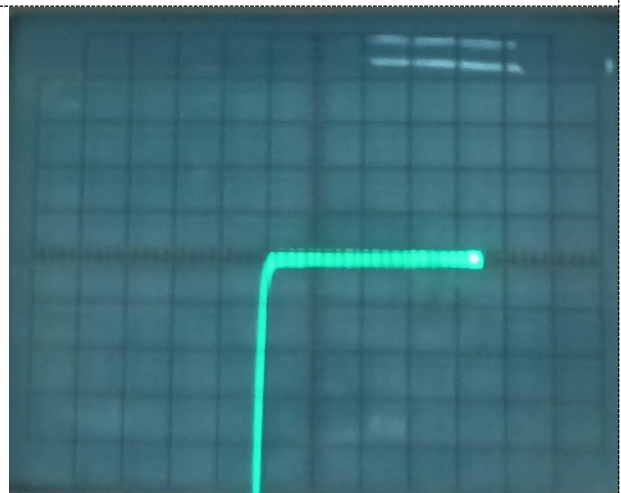
VSS TO PIN6



VSS TO PIN7



VSS TO PIN8





# 创芯在线电子检测中心

网站: <https://www.iclabcn.com>  
地址: 深圳市福田区中航路鼎诚国际大厦2603  
电话: 0755-82719442 邮箱: [engineer@iclabcn.com](mailto:engineer@iclabcn.com)



报告编号:	SZ20230323018
日期:	2023/03/23
页码:	10/13

## 电特性测试结果:

电特性测试	结果:
测试总量:	10 片
通过数量:	10 片
失败数量:	0 片
注:	所有样品的引脚均符合厂商规格说明, 通过。

## 5.开盖测试:

依据标准: AS6081

检测环境 环境温度: 24.1 °C 相对湿度: 56.3% RH

### 结论描述:

随机抽取客户提供制造商为 Microchip 型号 HCS300-I/SN 的样品 2 片 (#1-#2) 进行开盖检查。

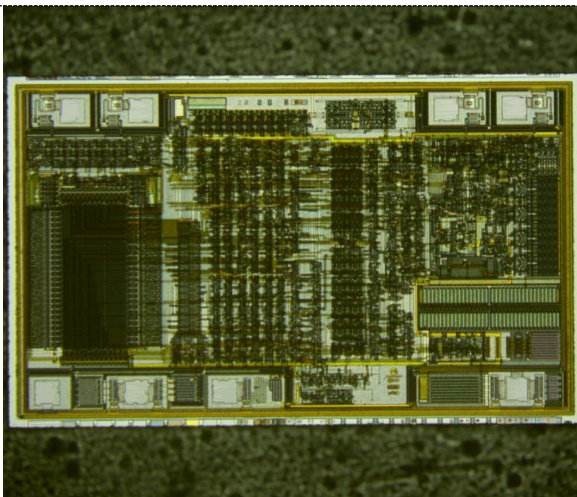
### 测试结果:

2 片样品开盖后均发现 Microchip 厂商标记和 1995 版权年及晶圆代码 77410 且结构一致。

### 测试结论:

确认2片样品die均为Microchip厂商产品。

#1-Die 全貌视图

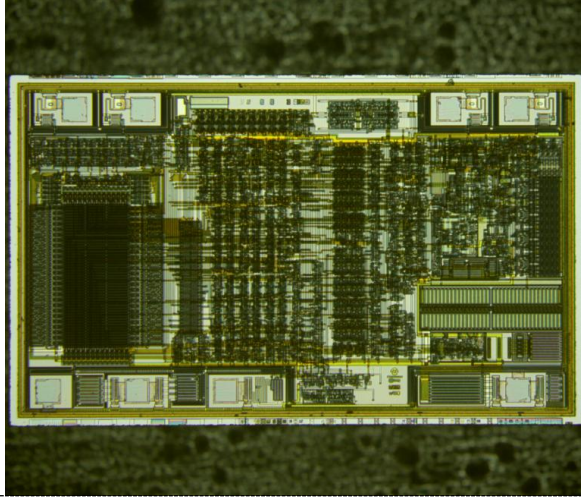


#1-Die 厂商 logo 和版权年及代码视图





#2-Die 全貌视图



#2-Die 厂商 logo 和版权年及代码视图



-报告结束-



# 创芯在线电子检测中心

网站: <https://www.iclabcn.com>  
地址: 深圳市福田区中航路鼎诚国际大厦2603  
电话: 0755-82719442 邮箱: [engineer@iclabcn.com](mailto:engineer@iclabcn.com)



报告编号:	SZ20230323018
日期:	2023/03/23
页码:	13/13

获得更多资讯, 请访问: <https://www.iclabcn.com>

## CXO实验室公众微信号

